

ひとわざ(一技)名: 高精度且つ、高アスペクト比の打抜き及び、精密な樹脂成形

1. 概要(200字目安)

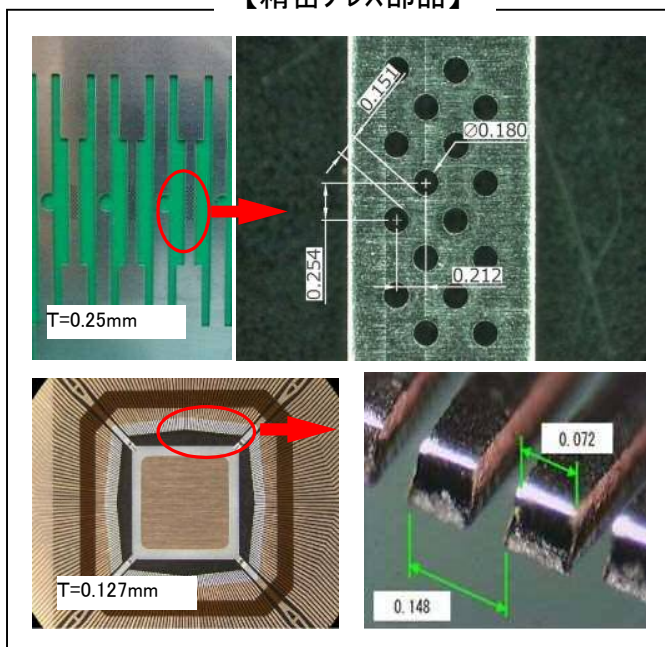
半導体、LED業界で培った高精度且つ高アスペクト比の打抜き および 精密な樹脂成形を得意としています。また、自社のリソースを使い、精密加工技術をベースにお客様の「こんなことが出来ないか？」を実現いたします。

- ・LED用樹脂付リードフレーム
- ・高耐久性各種ICタ
- ・マイクロプレート(臨床検査などで使用される実験・検査器具) など

写真・図(要点説明)

【精密プレス部品】

【LED用樹脂付リードフレーム】



2. 企業概況

会社名	アピックヤマダ株式会社	代表者名	押森 広仁
		窓口担当	柳原 君春
事業内容	半導体組立用金型・装置およびリードフレーム等精密プレス部品や精密成形部品の設計、製造、販売の一貫体制	URL	<a href="http://www.apicyamada.co.jp/">http://www.apicyamada.co.jp/</a>
主要製品	リードフレーム等精密プレス部品、樹脂封止用モールド装置、自動化機器装置、各種金型など		
住所	〒389-0898 長野県千曲市大字上徳間90番地		
電話/FAX	026-276-7913 / 026-276-2250	E-mail	yanagiharaki@apicyamada.co.jp
資本金(百万円)	5,837.50	設立年月日	昭和28年5月
		売上(百万円)	8,644
		従業員数	402

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他

- ①平成7年12月 ISO9002認証取得(リードフレーム)
- 平成12年12月 ISO9001認証取得(装置)
- 平成16年3月 ISO14001認証取得